Паспорт сервера

YasnoCore H200-8

Документ YCH2008 ПС 01 • Редакция 1.0 • 18.11.2026

8 × NVIDIA H200 NVL 141 ГБ • 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ RAM • 4U



Базовая платформа ASRock Rack 4U10G-GENOA2. Оригинальная фотография базовой платформы ASRock Rack; комплектация изображения справочная.

Параметр	Сведения модели
Изготовитель	ООО «ЯСНОКОР», ИНН 2100033229, ОГРН 1262100003175
Базовая платформа	ASRock Rack 4U10G-GENOA2; системная плата GENOA2D24G-2L+
Идентификация RAM	YCH2008-512-R0; YCH2008-1024-R0; YCH2008-2048-R0
Декларация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.83522/26 от 18.11.2026; срок до 17.11.2031
Связь с изготовителем	info@yasnocore.ru • +7 927 841-00-61 • cbr.yasnocore.ru

Паспорт описывает модель, варианты комплектования и порядок эксплуатации. Серийный номер, фактические артикулы, версии и записи контроля оформляются в разделе индивидуальных сведений экземпляра.

Для H200-8 в декларации указано проектное исполнение на рассматриваемой 4U10G-GENOA2. Окончательная комплектация подлежит подтверждению; полный режим питания, охлаждение и размещение плат согласуются для поставляемого изделия.

1 Назначение и конструкция

Сервер предназначен для обработки и хранения данных, вычислений и задач искусственного интеллекта в профессиональной ИТ-инфраструктуре. Эксплуатация предусмотрена в серверных помещениях и ЦОД обученным персоналом.

Ниже приведены характеристики базовой платформы из оригинальных руководств ASRock Rack. Их предельные возможности отделены от состава выбранного исполнения YasnoCore. Привязки M1 и B1 указывают печатные страницы руководств и физические страницы PDF; ссылки находятся в конце паспорта.

Сведения ASRock Rack	Источник
Базовая платформа ASRock Rack 4U10G-GENOA2; системная плата GENOA2D24G-2L+.	M1 стр. 1, 3 (PDF 6, 8)
Корпус для стойки 4U; габариты 786 × 438 × 176,5 мм (глубина × ширина × высота).	M1 стр. 3 (PDF 8)
Два сокета SP5 LGA6096. Платформа поддерживает AMD EPYC 9004, 97x4 и 9005; для 9005 требуется обновление BIOS.	M1 стр. 4 (PDF 9)
В таблице OEM указан TDP процессора до 400 Вт.	M1 стр. 4 (PDF 9)

Процессоры выбранного исполнения

Состав YasnoCore	Характеристики
2 × AMD EPYC 9354	На один CPU: 32 ядра, 64 потока; базовая частота 3,25 ГГц; номинальный TDP 280 Вт; SP5. Всего 64 ядра и 128 потоков.
Память CPU	DDR5 до 4800 MT/s. Рабочая скорость определяется процессором, модулями и настройкой BIOS.
Масса изделия	Указывается для фактической комплектации; в использованном руководстве платформы значение не приведено.

Источник параметров CPU: AMD EPYC 9354 [A1]. Частоты, температура и потребление под нагрузкой фиксируются для экземпляра; TDP не является измерением потребления всего сервера.

2 Оперативная память

Код исполнения	Объём RAM	Комплект DIMM
YCH2008-512-R0	512 ГБ	16 × 32 ГБ ECC DDR5 RDIMM
YCH2008-1024-R0	1024 ГБ	16 × 64 ГБ ECC DDR5 RDIMM
YCH2008-2048-R0	2048 ГБ	16 × 128 ГБ ECC DDR5 RDIMM

Сведения ASRock Rack	Источник
24 DIMM-разъёма: 12 на каждый CPU, 1DPC, DDR5 288-pin RDIMM и RDIMM-3DS.	M1 стр. 4 (PDF 9)
OEM указывает ёмкость одного RDIMM до 128 ГБ (2Rx4), RDIMM-3DS до 256 ГБ (2Rx4).	M1 стр. 4 (PDF 9)
В руководстве указаны DDR5 до 4800 МГц и напряжение DIMM 1,1 В.	M1 стр. 4 (PDF 9)
Рекомендация OEM для 16 DIMM и двух CPU: CPU0 — A1, B1, C1, E1, G1, H1, I1, K1; CPU1 — M1, N1, O1, Q1, S1, T1, U1, W1.	B1 стр. 21, 22 (PDF 28, 29)
OEM требует одинаковые DDR5 DIMM по изготовителю, скорости, объёму и типу микросхем в соответствующей конфигурации.	B1 стр. 21 (PDF 28)

Карта установки относится к GENOA2D24G-2L+ при двух CPU. Перед сборкой сверяют маркировку платы и её ревизию с руководством B1. Артикулы DIMM выбираются по Memory QVL; сочетание модулей и рабочая скорость фиксируются в паспорте экземпляра.

При установке 16 модулей используются восемь каналов памяти каждого CPU. Номинальная ёмкость RAM и физическая память GPU HBM относятся к разным подсистемам.

3 Накопители и расширение

Сведения ASRock Rack	Источник
С фронта предусмотрены 16 отсеков 2,5″ NVMe PCIe 5.0 x4 либо 24 отсека 2,5″ SATA/SAS с горячей заменой.	M1 стр. 3 (PDF 8)
Пассивный 24-портовый backplane NVMe/SATA/SAS; SAS требует дополнительного RAID/HBA.	M1 стр. 3 (PDF 8)
Два внутренних M-key M.2 PCIe 3.0 x4 или SATA 6 Гбит/с, форматы 2280/22110; по одному относится к CPU0 и CPU1.	M1 стр. 3 (PDF 8)
Сзади: десять FHFL двухслотовых PCIe 5.0 x16 через PCIe-коммутатор PEX89104.	M1 стр. 4 (PDF 9)
Сзади также два FHFL однослотовых PCIe 5.0 x8 через PEX89104; они делят физическое пространство с соседними двухслотовыми позициями.	M1 стр. 4 (PDF 9)
Один задний FHFL однослотовый PCIe 5.0 x16 имеет прямую связь с CPU.	M1 стр. 4 (PDF 9)
Спереди имеются два FHHL PCIe 5.0 x16 и отдельный OCP NIC 3.0 PCIe 5.0 x16.	M1 стр. 4 (PDF 9)

Накопители выбранного исполнения

В составе предусмотрены 2 × Samsung PM9A3 NVMe по 3,84 ТБ и контроллер Broadcom MegaRAID 9560-16i Tri-Mode. Заказной P/N SSD, ревизия backplane, кабели, порты и созданный массив фиксируются в схеме сборки.

Способ подключения NVMe к платформе или через MegaRAID определяется реальной кабельной схемой. Наличие Tri-Mode и перечисление поддерживаемых RAID-уровней не подтверждают созданный аппаратный массив. RAID 5/6/10 требуют соответствующего числа носителей; для двух SSD проверяется согласованный способ резервирования.

OCP является специализированным посадочным местом. GPU, Ethernet, FC, RAID и резервная позиция средства защиты размещаются по единой карте слотов с учётом общих пространств и доступных линий.

4 Панели и внешние интерфейсы



Фронтальная панель базовой платформы. Оригинальная фотография базовой платформы ASRock Rack; комплектация изображения справочная.



Задняя панель базовой платформы. Оригинальная фотография базовой платформы ASRock Rack; комплектация изображения справочная.

Сведения ASRock Rack	Источник
Два штатных порта RJ45 1GbE реализованы Intel i350; фронтальные и задние LAN-интерфейсы описаны как разделяемые.	M1 стр. 3, 4, 12 (PDF 8, 9, 17)
Фронтальные органы управления: Power с LED, Reset, NMI, UID с LED; индикаторы активности накопителей и системной неисправности.	M1 стр. 3, 11 (PDF 8, 16)
Фронтальная I/O панель: четыре USB 3.2 Gen1 Type-A, VGA DB15, разделяемые с задней панелью два 1GbE LAN и один выделенный IPMI LAN.	M1 стр. 3, 11 (PDF 8, 16)
Задняя I/O панель: два USB 3.2 Gen1 Type-A, VGA DB15, два разделяемых 1GbE LAN, выделенный разделяемый IPMI LAN; Power/Reset/NMI/UID и индикаторы.	M1 стр. 5, 12 (PDF 10, 17)

Передние и задние штатные LAN-разъёмы используют общие интерфейсы. Точки подключения выделенного IPMI LAN также разделяемые. Число видимых разъёмов не суммируется как число независимых сетевых адаптеров. Дополнительные X710-DA2 и FC HBA перечислены отдельно.

5 Управление и программное обеспечение

Сведения ASRock Rack	Источник
BMC ASPEED AST2600; отдельный управляющий GLAN через Realtek RTL8211F. Выделенный IPMI порт доступен с разделяемыми фронтальной/задней точками подключения.	M1 стр. 4, 12 (PDF 9, 17)
Встроенная графика ASPEED AST2600 с 512 МБ DDR4; выход VGA DB15.	M1 стр. 5 (PDF 10)
AMI UEFI BIOS; SPI Flash 256 Мбит (32 МБ). Указаны Instant Flash, ACPI 6.4 и выше, SMBIOS 3.5.0 и выше и Plug and Play.	M1 стр. 5 (PDF 10)
Контролируются температуры CPU, платы и области карт, обороты вентиляторов и питающие напряжения; поддерживается многоступенчатое управление вентиляторами.	M1 стр. 5 (PDF 10)
Плата имеет 13-контактный SPI TPM header. Наличие разъёма не устанавливает наличие самого модуля или сертификатов СЗИ.	B1 стр. 3 (PDF 10)
Руководство BIOS описывает Secure Boot и управление ключами; исходная настройка Secure Boot Disabled. Фактическое состояние фиксируют в паспорте экземпляра.	B1 стр. 93, 94, 95 (PDF 100, 101, 102)

Программный профиль YasnoCore

Компонент	Правило комплектования
Операционная система	Linux семейства Debian либо RHEL. Дистрибутив, версия, подписка и лицензии определяются спецификацией поставки.
GPU-программный стек	Совместимые NVIDIA Driver, CUDA Toolkit и cuDNN. Версии и параметры сохраняются с редакцией комплектации.
Управление	IPMI/KVM и доступные функции BMC. Состав Virtual Media и лицензий проверяется в поставляемом firmware.
Средства защиты	Совместимость с требуемыми СЗИ подтверждается отдельно для точных BIOS, платы, ОС и версий СЗИ. Наличие разъёма или функции BIOS не подтверждает поставку защитного модуля и лицензий.

Управляющий интерфейс размещают в выделенной сети с ограничением доступа. Учётные данные меняют при вводе в эксплуатацию; секреты и ключи в публичный паспорт не включаются. Обновления BIOS/BMC выполняют по инструкции соответствующей модели с резервной копией конфигурации и согласованным окном работ.

6 Состав исполнения YasnoCore

Количество указано на один сервер. Окончательный комплект поставки определяется подписанной спецификацией, а фактические P/N и S/N — индивидуальными сведениями экземпляра.

Узел	Модель и состав	Количество
Платформа	4U10G-GENOA2	1
CPU	AMD EPYC 9354	2
RAM	ECC DDR5 RDIMM; 512/1024/2048 ГБ	16 модулей
GPU	NVIDIA H200 NVL 141 ГБ PCIe	8
NVLink	Комплект 4-way для четырёх H200 NVL	2 группы
SSD	Samsung PM9A3 NVMe 3,84 ТБ	2
RAID	Broadcom MegaRAID 9560-16i Tri-Mode	1
Ethernet	Intel X710-DA2, 2 × 10GbE SFP+	2
Оптика Ethernet	SFP+ SR 10G LC/MMF	4
Fibre Channel	Emulex LPe31002-M6, 2 × 16G FC	1
Оптика FC	16G FC SW LC/MMF	2
Блоки питания	CRPS 2000 Вт при 200–240 В	4
Монтаж	Направляющие, кабельный организатор и силовой комплект	По спецификации
Резерв СЗИ	Совместимая свободная позиция для согласованного модуля защиты	По карте слотов

Физическое число деталей в комплекте NVLink, межслотовый шаг и силовые кабели задаются по точным артикулам выбранных GPU и OEM-комплекта. Резерв позиции для СЗИ не означает включение самого модуля и его лицензий.

В H200-8 вспомогательные карты и трансиверы не удваиваются автоматически с числом GPU. Их совместная установка и тепловой режим проверяются в окончательной сборке.

7 Графические ускорители и NVLink

Параметр	Исполнение модели
Ускорители	8 × NVIDIA H200 NVL PCIe; по 141 ГБ HBM3e
Суммарная физическая HBM	1128 ГБ; сумма памяти карт, не отдельная общая область памяти
Соединение	2 отдельные группы по четыре GPU с 4-way NVLink
Параметры одной H200 NVL	PCIe Gen5, двухслотовое воздушное исполнение; пропускная способность HBM 4,8 ТБ/с; TDP до 600 Вт [N1].
Установка	Точные OEM-позиции, P/N GPU, мостов и силового комплекта, шаг и CPU-домены фиксируются в карте сборки.

Логическая группировка

Группа NVLink 1	GPU в группе
Комплект 4-way 1	1, 2, 3, 4

Группа NVLink 2	GPU в группе
Комплект 4-way 2	5, 6, 7, 8

Две группы по четыре GPU не образуют единую восьмикарточную NVSwitch-сеть. Межгрупповая связь и её эффективность зависят от PCIe-топологии и программного стека.

Физическое число слотов платформы и официальный анонс поддержки H200 NVL учитываются вместе с точной спецификацией. OEM-публикация от 18.03.2024 называет обе GENOA2; запись NVIDIA QSC и адресное подтверждение полной комплектации имеют отдельную область проверки [P2].

Контроль после установки

- Сверить карту слотов с фактической маркировкой, PCIe BDF и CPU-доменами.
- Убедиться в обнаружении всех GPU и соединений NVLink; сохранить вывод nvidia-smi -L и nvidia-smi topo -m.
- Проверить ошибки PCIe/ECC/Xid, температуры, частоты и ограничения мощности при согласованной нагрузке.
- Проверить обмен между картами по утверждённой методике; сохранить версии ПО, команды и журналы.

8 Питание охлаждение и условия среды

Сведения ASRock Rack	Источник
Четыре CRPS по 2000 Вт при высоком входном напряжении; схема 3+1; 80 PLUS Platinum.	M1 стр. 3 (PDF 8)
При входе 100–127 В AC один модуль ограничен 1000 Вт; при 200–240 В AC — 2000 Вт. Частота в OEM указана как 47/63 Гц.	M1 стр. 3 (PDF 8)
OEM описывает три БП для полной нагрузки и четвёртый как резервный с разделением нагрузки; допускается извлечение одного БП без нарушения работы системы в допустимом резервируемом режиме.	M1 стр. 25 (PDF 30)
Пять средних вентиляторов 80×80 мм с горячей заменой, FAN1–FAN5 слева направо. При замене стрелка направления на вентиляторе должна указывать назад корпуса.	M1 стр. 3, 8, 27 (PDF 8, 13, 32)
Температура эксплуатации платформы: от +10 до +35 °C.	M1 стр. 5 (PDF 10)
Температура в нерабочем состоянии: от −40 до +70 °C; влажность в нерабочем состоянии 20–90%, без конденсации.	M1 стр. 5 (PDF 10)

Номинальный расчёт при 200–240 В

Расчётная величина	Значение
Сумма установленной мощности БП	4 × 2000 = 8000 Вт DC
Ёмкость при схеме 3+1	3 × 2000 = 6000 Вт DC
Номиналы GPU и CPU	8 × 600 + 2 × 280 = 5360 Вт
Остаток до учёта остальных узлов	6000 − 5360 = 640 Вт

Расчёт не включает RAM, вентиляторы, SSD, платы и коммутацию; потребление AC измеряется отдельно. Наличие четырёх БП и схема 3+1 сами по себе не подтверждают резервирование двух вводов A/B. Распределение по PDU/ИБП проверяется для полной нагрузки и отказа заданного ввода.

Для восьми H200 при 600 Вт на GPU остаётся 640 Вт до остальных узлов. Полная нагрузка, охлаждение и работа при отказе БП требуют отдельного подтверждения. Пределы для низковольтного ввода нельзя применять к расчёту 6000 Вт при 3+1.

9 Монтаж и ввод в эксплуатацию

Сведения ASRock Rack	Источник
Для обслуживания снимаются передняя/задняя верхние крышки; до восстановления питания крышки должны быть установлены обратно.	M1 стр. 19, 20, 21, 22 (PDF 24, 25, 26, 27)
2,5″ носитель фиксируется в салазках четырьмя боковыми штифтами, салазки вставляются до полной посадки и запираются рычагом.	M1 стр. 23, 24 (PDF 28, 29)
GPU устанавливается в выбранный слот, фиксируется винтом; питание подаётся предустановленным 12V-2x6 со switch board либо подходящим 8-pin кабелем комплекта, соединения должны защёлкнуться полностью.	M1 стр. 30, 31 (PDF 35, 36)
OCP-карта устанавливается в свой слот после снятия заглушки и фиксируется ручным винтом.	M1 стр. 32, 33 (PDF 37, 38)
Для SP5 используется CPU с carrier frame; не разделять CPU и рамку. Схема затяжки радиатора дана OEM; момент 10,8–13,0 in-lb, по четверти оборота, последовательность 1→2→3→4→5→6, ослабление в обратном порядке.	M1 стр. 39, 41, 43 (PDF 44, 46, 48)
DIMM допускает только одну ориентацию. Силовая установка в неверном положении повреждает модуль и плату; точная карта заполнения берётся из руководства платы.	M1 стр. 44 (PDF 49)
Комплект направляющих содержит наружную, среднюю и внутреннюю секции; L ставится слева, R справа. Внутренние рельсы крепятся к корпусу, наружные — к стойке; фиксатор шарикоподшипника перед установкой должен быть спереди и заблокирован.	M1 стр. 45, 46, 47 (PDF 50, 51, 52)
В коробке OEM: barebone с десятью 12V-2x6 кабелями, два радиатора CPU, один rail kit; accessory box включает по десять CPU 8-pin и PCIe 8-pin кабелей, четыре сетевых шнура, QIG и два винта M.2.	M1 стр. 2 (PDF 7)

Последовательность ввода

1. Сверить изделие и упаковку со спецификацией; записать S/N, P/N, ревизии и повреждения, если они есть.
2. Подготовить стойку, направляющие, заземление, вводы питания, вентиляцию и сеть управления. Исключить одновременное выдвижение нескольких тяжёлых устройств из стойки.
3. Проверить установку CPU, DIMM, карт, мостов, носителей и воздуховодов по схеме сборки. Внутренние работы проводит подготовленный персонал.
4. Подключить согласованные силовые и сетевые кабели; задать доступ к BMC и сохранить исходную конфигурацию.
5. При первом включении проверить POST и перечень CPU/RAM/SSD/PCIe; записать BIOS/BMC и параметры памяти.
6. Установить согласованную ОС и GPU-стек, затем выполнить функциональные и нагрузочные проверки. Сохранить журналы и замечания.
7. Оформить паспорт экземпляра, комплектность, результат приёмки и сервисные условия. Передать документацию и резервные копии конфигураций заказчику.

10 Индикация диагностика и обслуживание

Сведения ASRock Rack	Источник
UID выключен — идентификация отключена; синий — включена. Кнопка включает/отключает передний и задний UID.	M1 стр. 13 (PDF 18)
Индикатор питания: выключен — питание выключено; зелёный — система включена.	M1 стр. 13 (PDF 18)
System Fault LED: выключен — нормальная работа; красный — хотя бы один датчик выдал критический сигнал.	M1 стр. 13 (PDF 18)
LED БП: зелёный — выход включён и исправен; мигающий зелёный 0,5 Гц — только 12VSB либо Smart Redundant; янтарный — неисправность/защита или отключённый AC-шнур; мигающий янтарный 0,5 Гц — предупреждение.	M1 стр. 16 (PDF 21)
LED питания корзины: выключен — нет питания, синий — питание есть. LED активности: выключен — накопитель отключён, зелёный — активен, мигает зелёным — доступ/чтение, красный — отказ.	M1 стр. 17 (PDF 22)
Выделенный IPMI LAN: Link Off — нет связи, мигающий жёлтый — обмен, On — связь; Speed Off — 10 Мбит/с или нет связи, оранжевый — 100 Мбит/с, зелёный — 1 Гбит/с.	M1 стр. 14 (PDF 19)
У 1GbE LAN цвет Speed зависит от стороны: спереди оранжевый 100 Мбит/с и зелёный 1 Гбит/с; сзади зелёный 100 Мбит/с и оранжевый 1 Гбит/с.	M1 стр. 15 (PDF 20)

Действия при отклонениях

Признак	Проверка и действие
Системный Fault или перегрев	Сохранить события BMC/SEL и показания датчиков. Проверить потоки воздуха, вентиляторы, крышки и условия помещения; согласовать снижение или остановку нагрузки.
GPU не обнаружена или нет NVLink	Проверить журнал ОС, PCIe, драйвер и карту соединений. Внутренние подключения проверяют после штатного отключения всех вводов питания.
Событие накопителя или RAID	Сохранить состояние контроллера/SSD, определить проблемный носитель по идентификатору. Замена и восстановление выполняются по согласованной процедуре с резервной копией.
Предупреждение БП	Проверить все AC-вводы, PDU/ИБП и код индикации. Горячая замена допускается только при достаточной оставшейся мощности и по процедуре OEM.

Периодичность профилактики устанавливается регламентом площадки с учётом запылённости и нагрузки. Записи о чистке, замене узлов и обновлениях вносятся в журнал. Сжатый воздух, инструменты и расходные материалы применяют только по одобренной сервисной процедуре.

11 Безопасность хранение и сопровождение

Сведения ASRock Rack	Источник
Перед обслуживанием выключить систему и отсоединить все источники питания. Кнопка Power переводит в standby и не обесточивает внутренние цепи полностью.	M1 стр. 18 (PDF 23)
Монтаж/обслуживание выполняет подготовленный персонал; питание подключается к заземлённой розетке; при работе с компонентами применяют ESD-защиту и берут платы за края.	M1 вводные сведения по безопасности (PDF 4)
При замене батареи использовать правильный тип; отработанные батареи утилизировать по инструкции. Неверный тип создаёт риск взрыва.	M1 вводные сведения по безопасности (PDF 4)

Перемещение и хранение

Используют подходящую упаковку и защиту от ударов, пыли, влаги и электростатического разряда. Модули и кабели закрепляют по транспортной инструкции. Перемещение укомплектованного сервера выполняют с подходящими средствами и числом подготовленных работников.

По OEM: нерабочая температура −40…+70 °C; нерабочая влажность 20–90% без конденсации [M1, стр. 5]. Эти значения не являются диапазоном рабочей влажности. После перемещения из холодной среды включение допускается после выравнивания температуры и полного исчезновения конденсации.

Гарантия и техническая поддержка

Срок гарантии, дата её начала, сервисный документ, перечень услуг и SLA указываются в договоре и индивидуальном разделе паспорта. Расширенная поддержка оформляется отдельным сертификатом или приложением к поставке. Настоящий паспорт не задаёт новый срок гарантии вместо согласованных условий.

Обращение направляется изготовителю с моделью, S/N, описанием проявления, временем и безопасно подготовленными диагностическими материалами. Способ передачи журналов согласуется отдельно. Носители с данными и удалённый доступ обрабатываются по договору и правилам заказчика.

Изготовитель и контакты

Сведения	Контакт
Изготовитель	ООО «ЯСНОКОР», ИНН 2100033229, КПП 210001001, ОГРН 1262100003175
Юридический адрес	428003, г. Чебоксары, пл. Речников, д. 7, к. 1, кв. 144
Площадка сборки	428003, г. Чебоксары, пл. Речников, д. 1, помещения 19 и 20
Техническая связь	info@yasnocore.ru; +7 927 841-00-61; https://cbr.yasnocore.ru/

12 Сведения о конкретном экземпляре

Раздел заполняется при изготовлении и передаче сервера. Подтверждённые записи относятся только к указанному экземпляру и редакции его комплектации. Поля остаются пустыми до внесения фактических данных.

Идентификатор	Данные экземпляра
Модель	YasnoCore H200-8
Код исполнения и редакция комплектации	_____
Серийный номер и дата изготовления	_____
Платформа и ревизия платы	_____
P/N и S/N CPU и DIMM	По приложенной ведомости № _____
P/N и S/N GPU и мостов	По приложенной ведомости № _____
P/N и S/N SSD и контроллера	_____
Карта PCIe и схема NVMe/RAID	Документы № _____
Модели БП и силового комплекта	_____
BIOS и BMC	_____
ОС ядро драйвер NVIDIA CUDA cuDNN	_____
Договор и комплектность	_____
Документ гарантии и срок	_____
Протокол и первичные журналы	_____
Контролёр дата и подпись	_____
Решение о приёмке и замечания	_____

Функциональные и нагрузочные результаты записывают в протоколе с серийным номером, условиями, методикой и версиями ПО. Расчётные показатели и документация платформы не заполняют фактические результаты контроля.

13 Соответствие источники и учёт изменений

На модели H200-4 и H200-8 зарегистрирована декларация ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.83522/26 от 18.11.2026, срок действия до 17.11.2031, схема 1д, серийный выпуск. Регламенты: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016. Статус в выгрузке ФСА от 18.11.2026: «Действует».

Область H200-8 в декларации содержит проектное исполнение и рассматриваемую 4U10G-GENOA2; окончательная комплектация подлежит подтверждению.

Декларация PDF • Запись в реестре ФСА

Технические источники

M1 ASRock Rack 4U10G-GENOA2 User Manual v1.03, январь 2026. Характеристики: стр. 3–5; обзор и панели: 6–12; индикация: 13–17; установка и обслуживание: 18–33; плата: 34–44; монтаж в стойку: 45–47.
Открыть источник M1

Q1 ASRock Rack 4U10G-GENOA2 Quick Installation Guide v1.0. Обзор соединений и монтажа.
Открыть источник Q1

B1 ASRock Rack GENOA2D24G-2L+ User Manual v3.30, октябрь 2026. Карта 16 DIMM: печатная стр. 22, PDF 29. Применять разделы своей модели платы.
Открыть источник B1

P1 Официальная карточка базовой платформы ASRock Rack; ключевые характеристики проверены 18.11.2026. Полная таблица Specifications сохранена 17.11.2026.
Открыть источник P1

P2 Официальное заявление ASRock Rack о поддержке H200 NVL, 18.03.2024. Абзац после описания NVIDIA MGX, где перечислены обе GENOA2.
Открыть источник P2

N1 NVIDIA H200, публичная таблица спецификаций H200 NVL. Характеристики GPU и группировка NVLink.
Открыть источник N1

A1 AMD EPYC 9354, официальные характеристики процессора.
Открыть источник A1

Журнал обслуживания и изменений

Дата	Работа или изменение	Документ и исполнитель
_____	_____	_____
_____	_____	_____